

中芯国际介绍

港交所股份代号: **00981**

上交所科创板证券代码: **688981**

美国场外市场交易代码: **SMICY**

中芯国际投资者关系

2020年8月

前瞻性陈述



本次报告可能载有（除历史数据外）「前瞻性陈述」。该等前瞻性陈述，包括“季度指引”、“资本开支概要”和包含在联合首席执行官引言里的叙述，乃根据中芯国际对未来事件或绩效的现行假设、期望、信念、计划、目标及预测而作出。中芯国际使用「相信」、「预期」、「打算」、「估计」、「期望」、「预测」、「目标」、「前进」、「继续」、「应该」、「或许」、「寻求」、「应该」、「计划」、「可能」、「愿景」、「目标」、「旨在」、「渴望」、「目的」、「预定」、「展望」、和类似的表述，以识别前瞻性陈述，虽然不是所有的前瞻性陈述包含这些词。该等前瞻性陈述乃反映中芯国际高级管理层根据最佳判断作出的估计，存在重大已知及未知的风险、不确定性以及其它可能导致中芯国际实际业绩、财务状况或经营结果与前瞻性陈述所载资料有重大差异的因素，包括（但不限于）与半导体行业周期及市场有关风险、半导体行业的激烈竞争、中芯国际对于少数客户的依赖、中芯国际客户能否及时接受晶圆产品、能否及时引进新技术、中芯国际量产新产品的能力、半导体代工服务供求情况、行业产能过剩、设备、零件及原材料短缺、制造产能供给、终端市场的金融情况是否稳定、来自未决诉讼的命令或判决、半导体行业常见的知识产权诉讼、宏观经济状况，及货币汇率波动。

除本报告所载的数据外，阁下亦应考虑中芯国际不时向香港联交及上交所所呈报的其他文件。其他未知或未能预测的因素亦可能会对中芯国际的未来业绩、表现或成就造成重大不利影响。鉴于该等风险、不确定性、假设及因素，本报告所讨论的前瞻性事件可能不会发生。阁下务请小心，不应不当依赖该等前瞻性陈述，有关前瞻性陈述仅视为于其中所载日期发表，倘并无注明日期，则视为于本报告刊发日期发表。除适用法律可能会有要求外，中芯国际不承担任何义务，亦无意图更新任何前瞻性陈述，以反映该陈述发布日期之后的事件或情况，或反映该陈述发布日期之后发生的意外事件，或以反映意外事件的发生，无论是否有新的信息、将来的事件或是其它原因。

关于非国际财务报告准则(「非国际准则」)的财务计量

合并财务信息按照国际财务报告准则(“IFRS”)编制，除非另有说明，否则按照国际财务报告准则提交。

中芯国际在此份报告里使用了非国际准则的营运结果计量，包含非国际准则的营运开支,调整后的税息折旧及摊销前利润, 以及调整后的税息折旧及摊销前利润率。请协同参阅本集团遵照国际财务报告准则编制的财务计量, 具体解释请参阅业绩报告。

本报告期内二零二零年一、二季度业绩数据未经审核

I.
市场机遇

II.
中芯简介

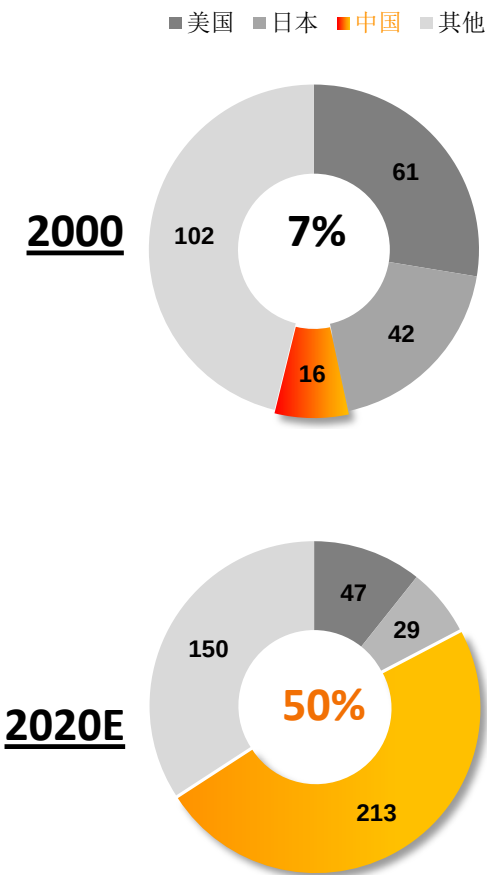
III.
中芯业绩

IV.
成长策略

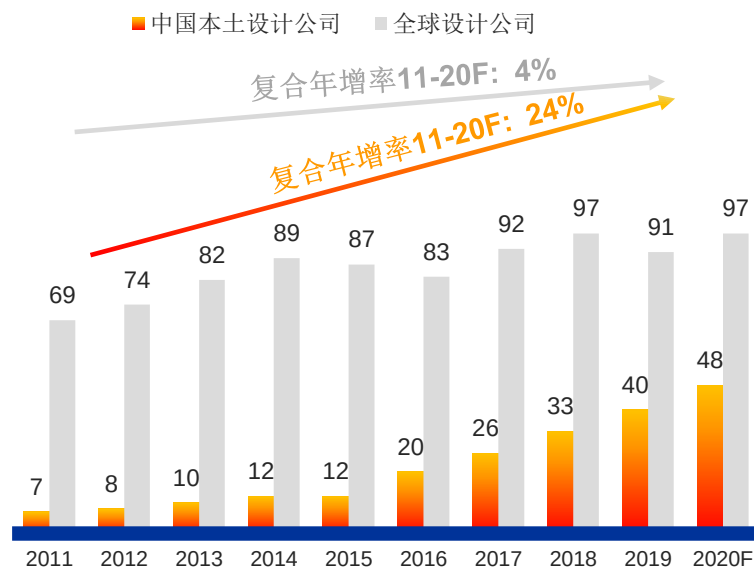
V.
总结

中国芯片市场快速成长

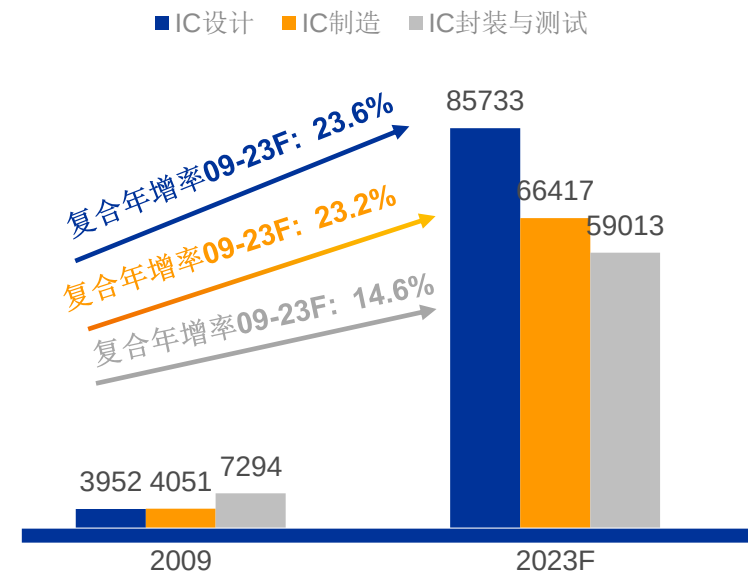
中国为全球最大芯片市场 (单位: 十亿美元)



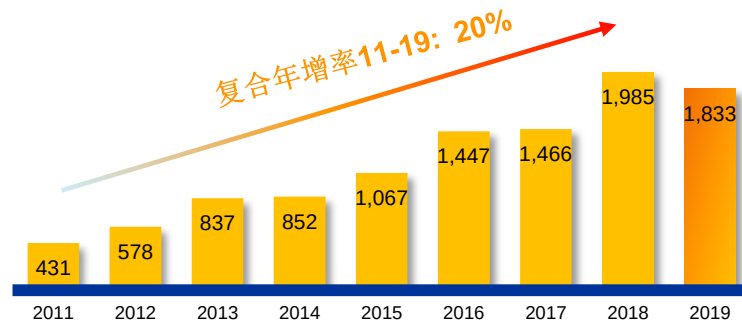
中国芯片设计成长率 (单位: 十亿美元)



中国集成电路市场发展 (单位: 百万美元)



中芯国际来自于中国本土客户的收入迅猛增长 (单位: 百万美元)



* 2018年中芯中国收入包括一次性技术授权费约1.6亿美元



来源:
中芯根据第三方数据分析得来, 更新于2020年1季度

I.
市场机遇



III.
中芯业绩

IV.
成长策略

V.
总结

中芯国际是中国大陆地区规模最大, 技术最先进的集成电路晶圆代工厂

2000年成立



在港交所及
上交所科创板上市



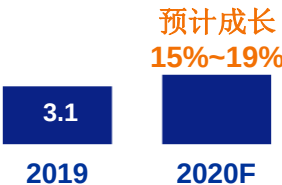
中国大陆地区
规模最大



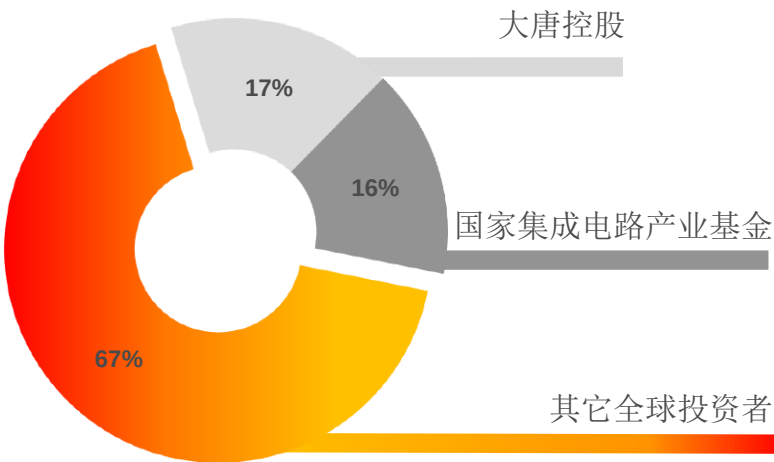
全球纯晶圆代
工第四



年收入: (单位:十亿美元)



股东结构



截至2019年12月31日

中芯国际在中国芯片产业链中占有举足轻重的地位



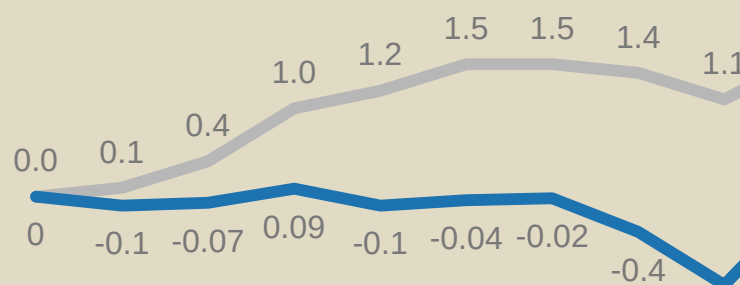
全球分布



筑基扬帆，重启加速成长

早期

中芯年收入: (单位:十亿美元)



中芯应占利润: (单位:十亿美元)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

扭亏为盈

重启成长

中国大陆代工厂首选

目标:

成为世界一流的主流代工厂



加速技术研发



建立关键平台和战略联盟



中芯国际产能布局

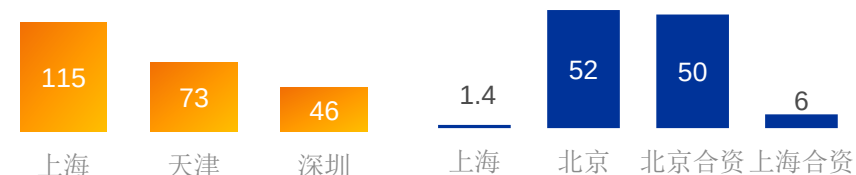
立足中国·走向世界



总产能为48万 8寸 约当产能/月（截止2Q20底）

23.4万片 8" 晶圆月产能

10.9万片 12" 晶圆月产能



新厂

扩产前提:

- 市场与客户需求确定
- 技术准备就绪

上海合资12"

- 控股合资厂, 14nm及更先进技术
- 合资方为国家集成电路产业基金与上海集成电路产业基金

天津 8"

- 有望成为全球单体规模最大的8英寸集成电路生产线

I.
市场机遇

II.
中芯简介

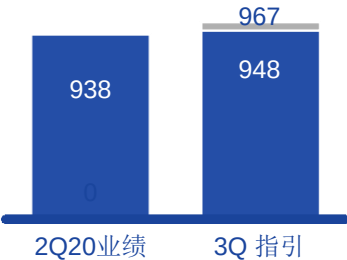
III.
中芯业绩

IV.
成长策略

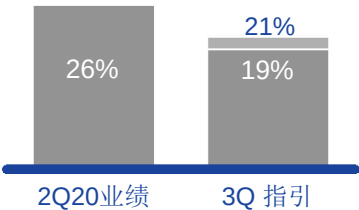
V.
总结

财务摘要 – 2020年二季度

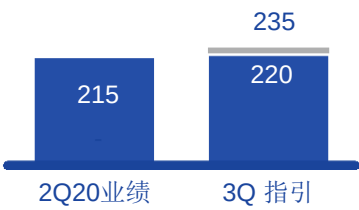
收入(单位:百万美元)



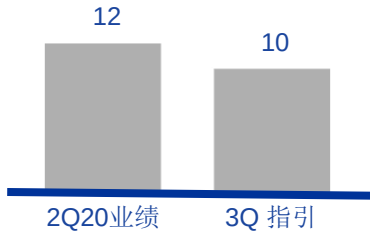
毛利率



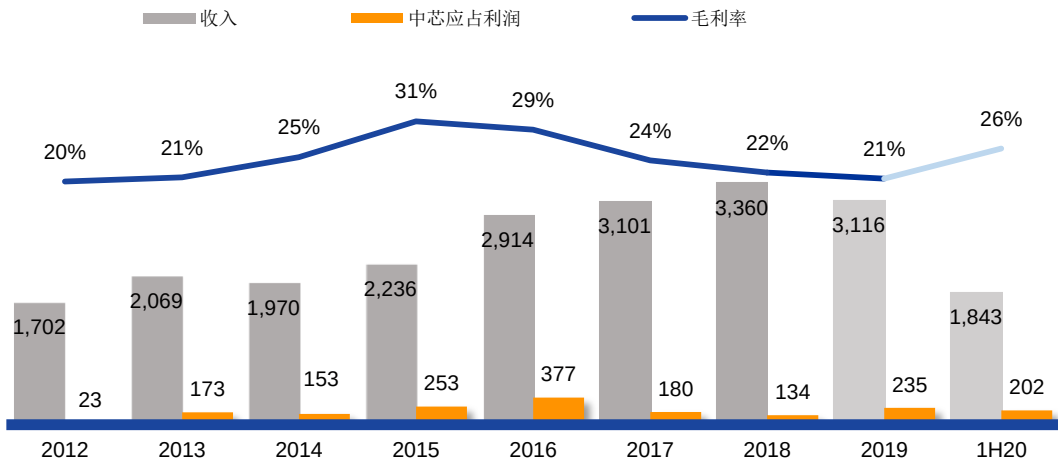
非国际准则的经营开支
(单位:百万美元)



非控制权益(单位:百万美元)

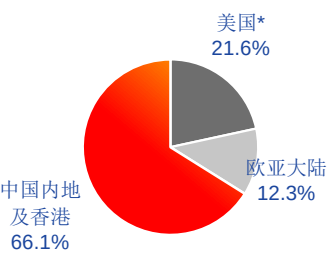


收入与获利 (单位:百万美元)

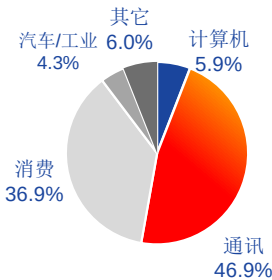


收入来源多样 — 2Q 20

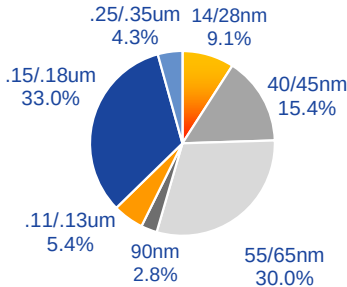
收入按地区分类



收入按应用分类



晶圆收入按制程分类



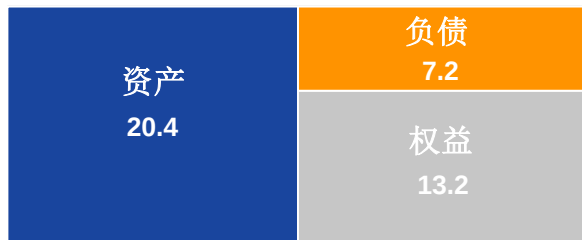
备注: 2013年以前的数据采用美国公认会计准则的财务报表, 2013年以后的数据采用国际财务报告准则。

*呈列之收入为总公司位于美国, 但最终出售及付运产品予全球客户的公司。

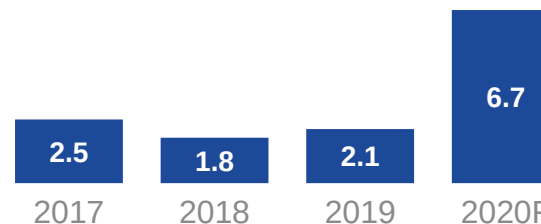
资本开支，税息折旧及摊销前利润与现金储备



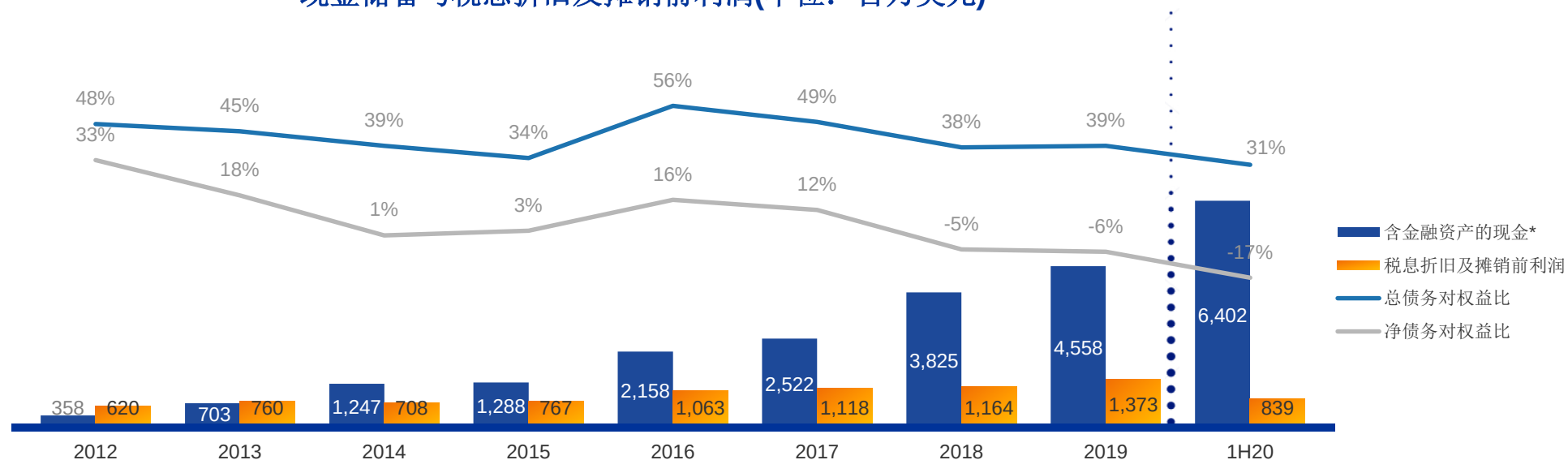
资产负债表 (单位: 十亿美元)



资本开支 (单位: 十亿美元)



现金储备与税息折旧及摊销前利润(单位: 百万美元)

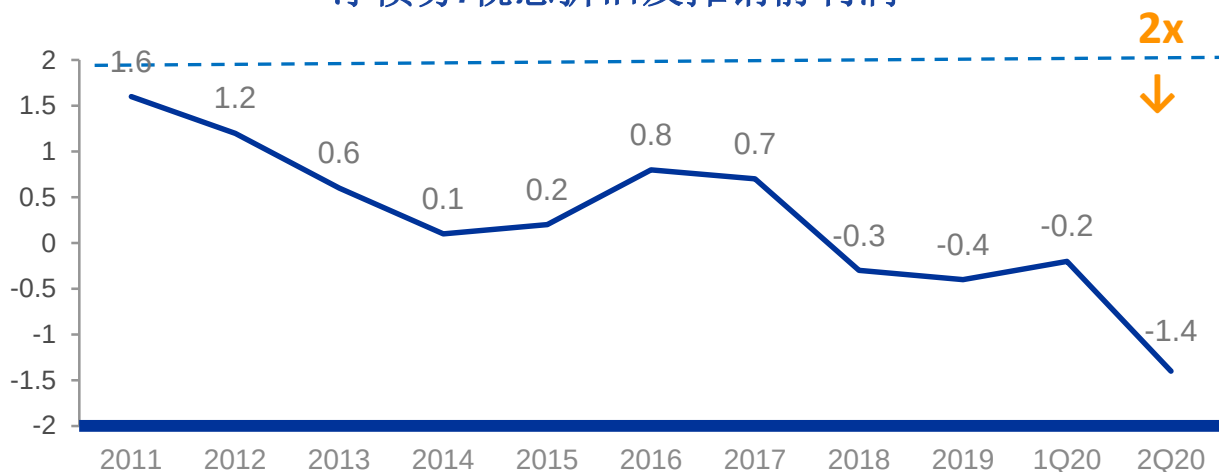


* 包括现金和现金等价物以及流动金融资产，不含限制性现金。

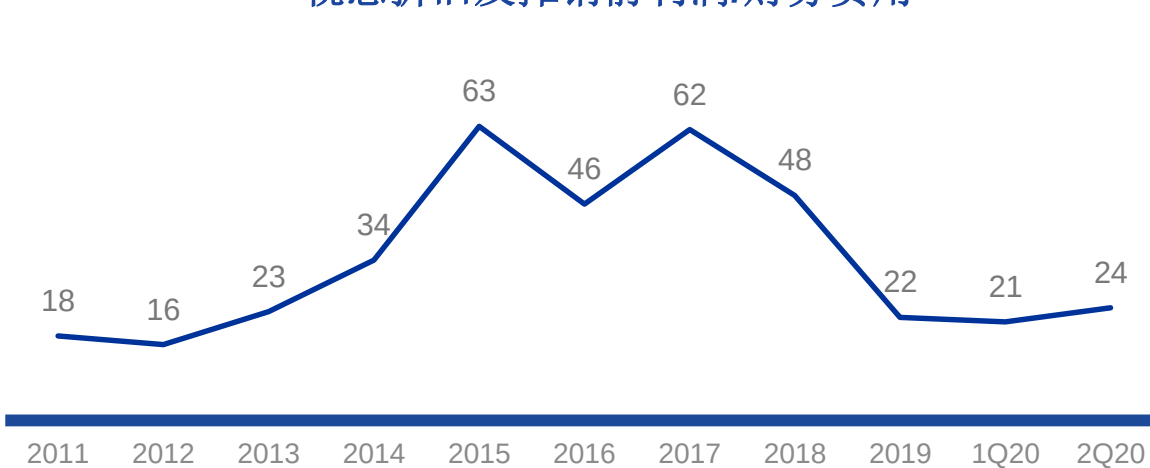
投资级别信用评级

- ✓ 自2013年10月获得标准普尔投资级别 **BBB-** 长期公司评级
- ✓ 自2015年10月获得穆迪 投资级别 **Baa3** 公司评级
- ✓ 自2015年11月获得中诚信国际信用评级公司的**AAA**评级
- ✓ 致力于维持投资信用评级, 净债务对税息折旧及摊销前利润低于2x

净债务/税息折旧及摊销前利润



税息折旧及摊销前利润/财务费用



I.
市场机遇

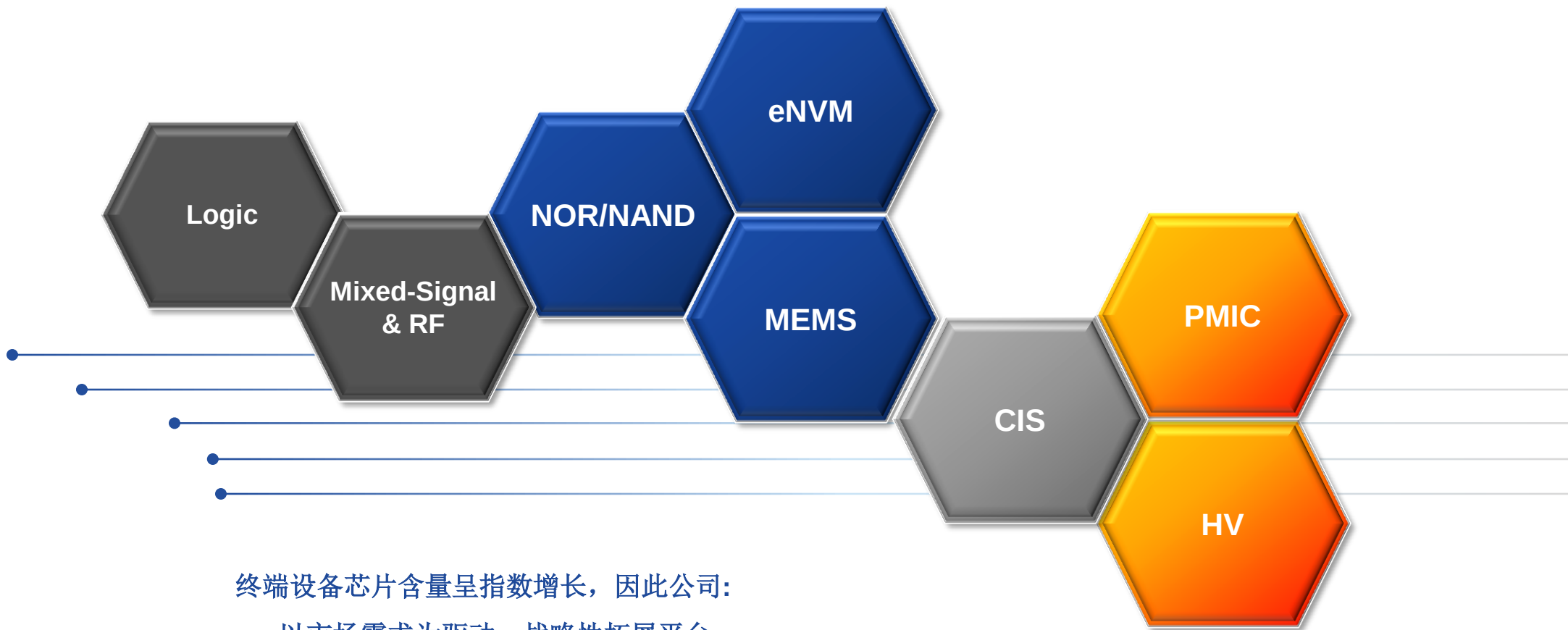
II.
中芯简介

III.
中芯业绩

IV.
成长策略

V.
总结

多平台驱动的多样化成长战略

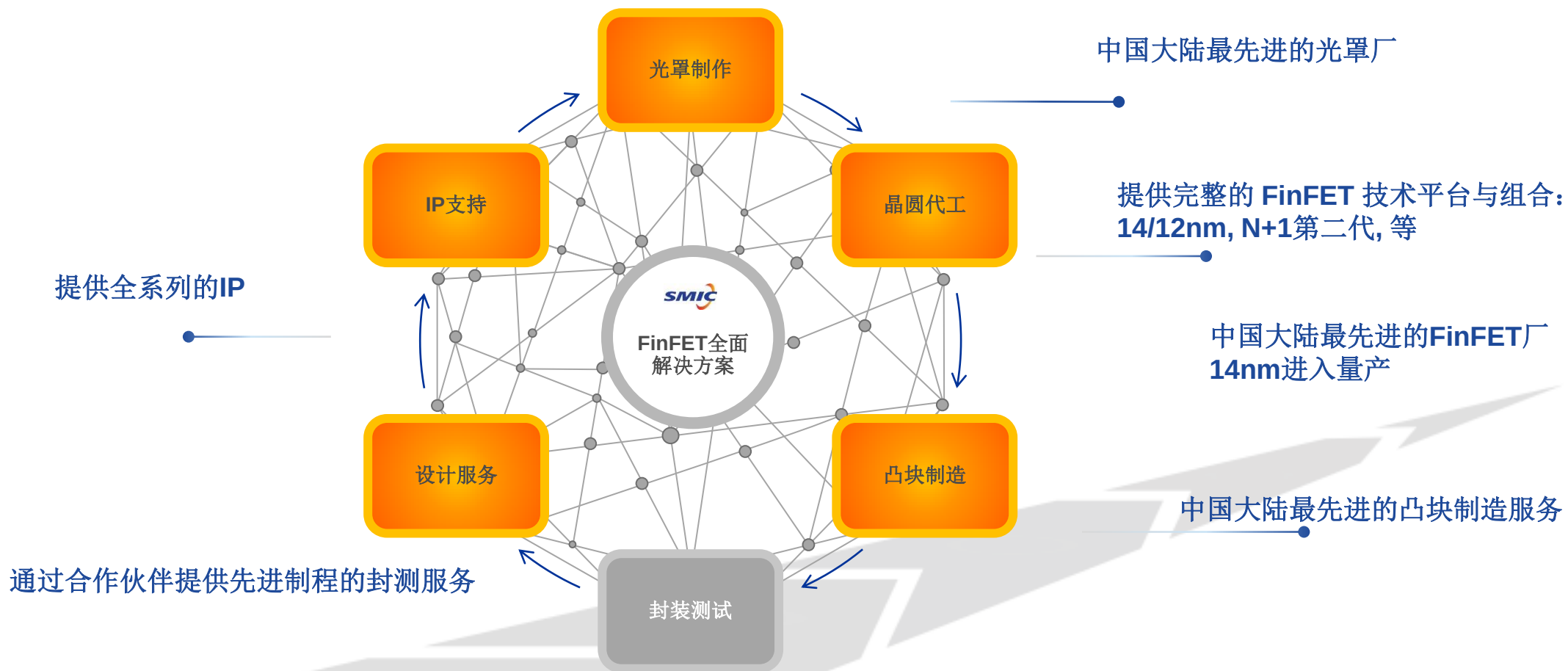


终端设备芯片含量呈指数增长，因此公司：

- 以市场需求为驱动，战略性拓展平台
- 不断创新产品平台，推动增长
- 图像处理、电源管理等平台保持行业领先

进入 FinFET 新时代

中芯国际通过给客户提供一站式FinFET全面解决方案确保长期合作共赢



市场机会



为更好的为客户服务，中芯国际正扩展丰富其FinFET产品技术平台与组合以满足各种产品应用领域



智能手机



智能电视&机顶盒



高速运算



网络通信



无线连接



汽车电子

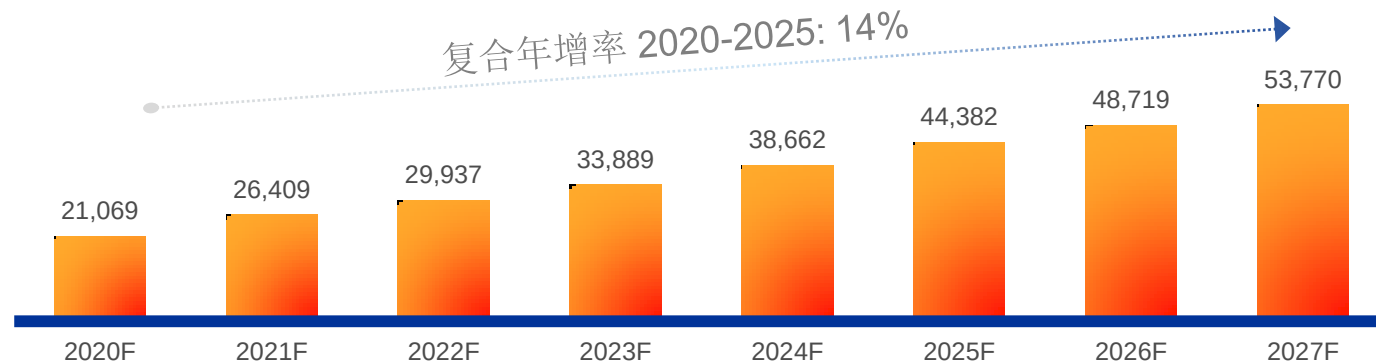


人工智能



物联网

FinFET 市场收入: 14纳米及以下 (单位: 十亿美元)



来源: 中芯根据第三方数据分析得来, 更新于2020年1季度

I.
市场机遇

II.
中芯简介

III.
中芯业绩

IV.
成长策略

V.
总结



目标成为世界一流的晶圆代工企业

执行

- 成熟工艺平台坚实及产能已满
- 先进技术FinFET开发，稳健上量

技术

- 14nm量产
- 第二代FinFET技术完成客户产品验证
- 加速先进技术研发
- 有竞争力的差异化平台
- 全面的FinFET解决方案

财务

- 信用评级：投资级别
- 截止2020年2季度末约有64亿美元现金
- 预计2020全年税息折旧及摊销前利润约18亿美金
- 先进制程厂采用合资方式进行运营

定位

- 中国大陆最大最先进的晶圆代工厂
- 中国半导体生态圈优选伙伴

谢谢

联系我们: ir@smics.com